

助焊剂

# FLUX

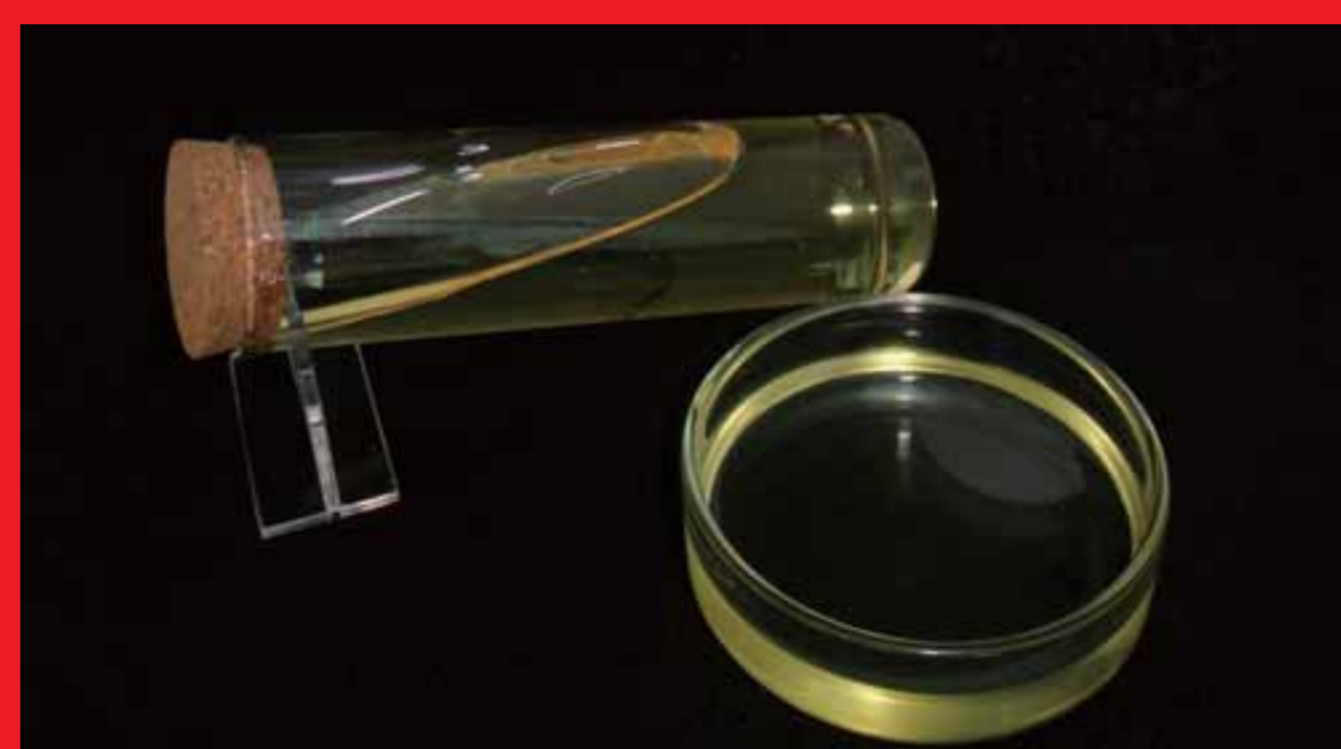
理想的“润湿性”，连接全世界

## SPK-3400

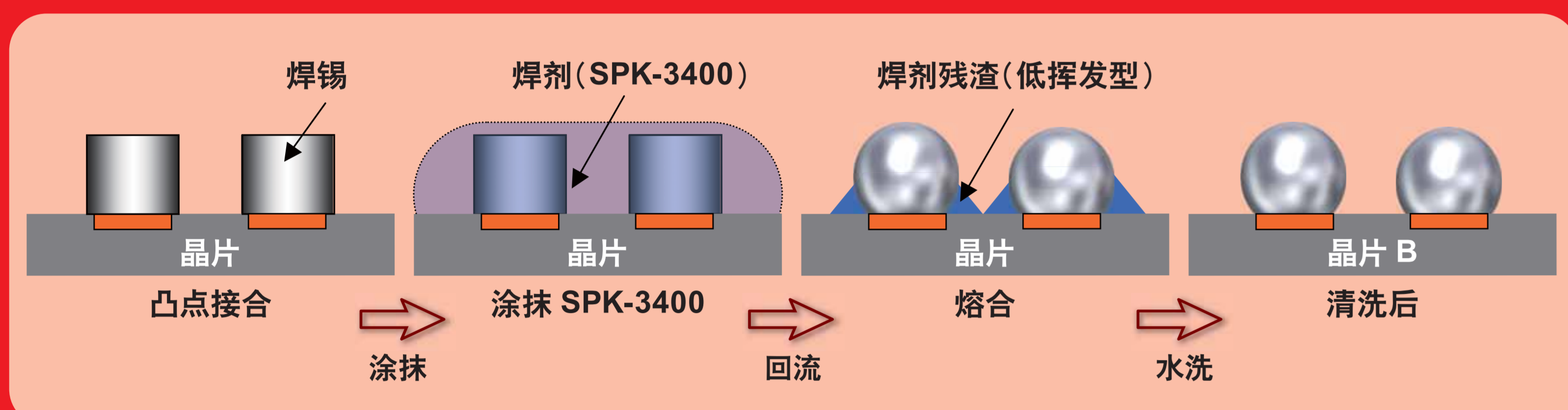
凸点熔合用 低挥发焊剂  
火花牌焊剂 SPK-3400

特点

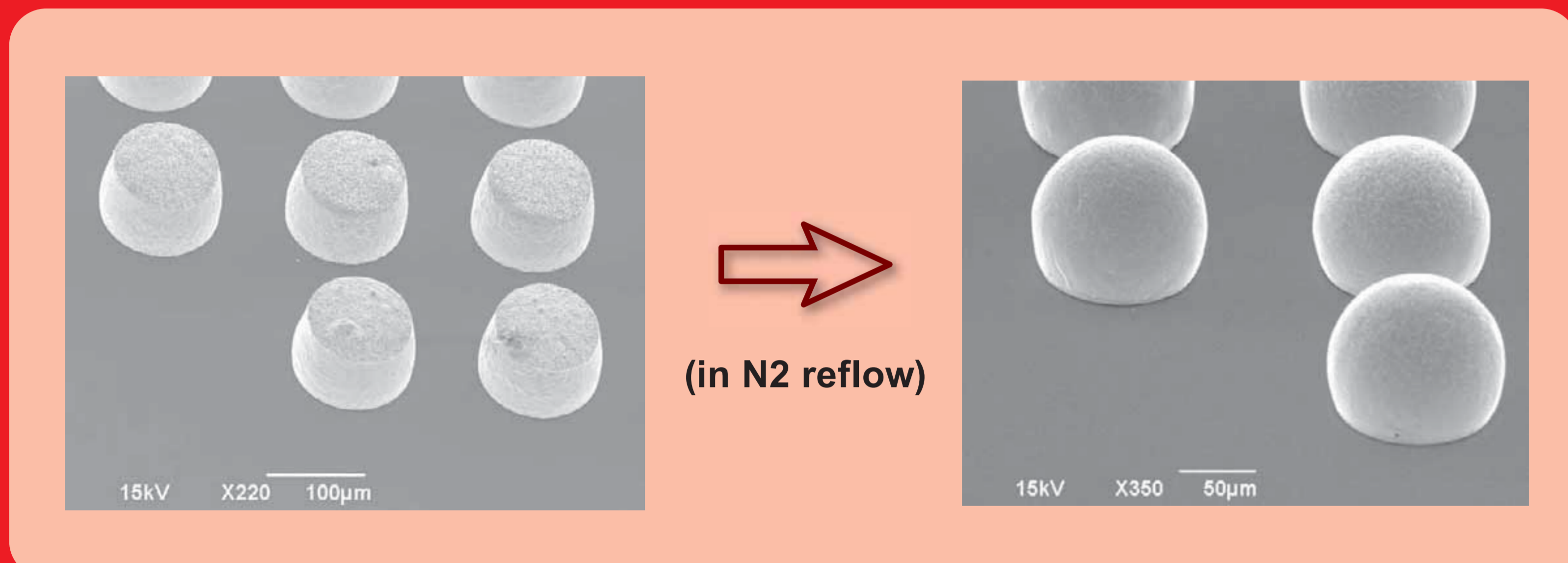
- 不易滴落，抗氧化效果好，抑制炉内污染
- 可通过喷射装置或旋涂进行供料。
- 由于晶片表面不易滴落，减轻了炉内污染。
- 低挥发焊剂，可有效除去氧化膜。
- 高温回流后也可水洗的无卤素焊剂



□ SPK-3400 可形成均一球状凸点，轻松水洗可除去焊剂残渣



□ 融合性优异的 SPK-3400



## JPK8

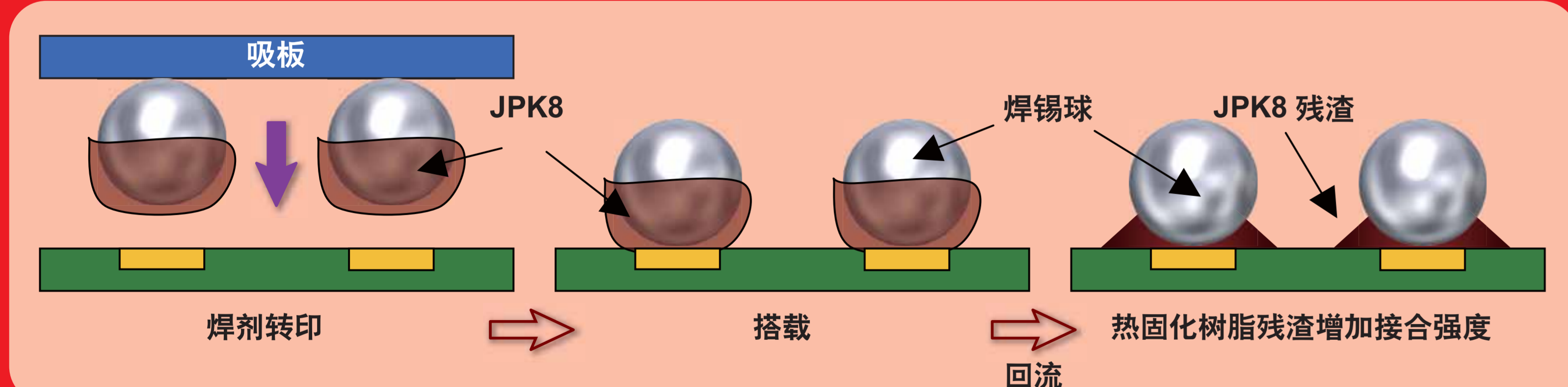
通过残渣加强接合的  
球实用助焊剂

特点

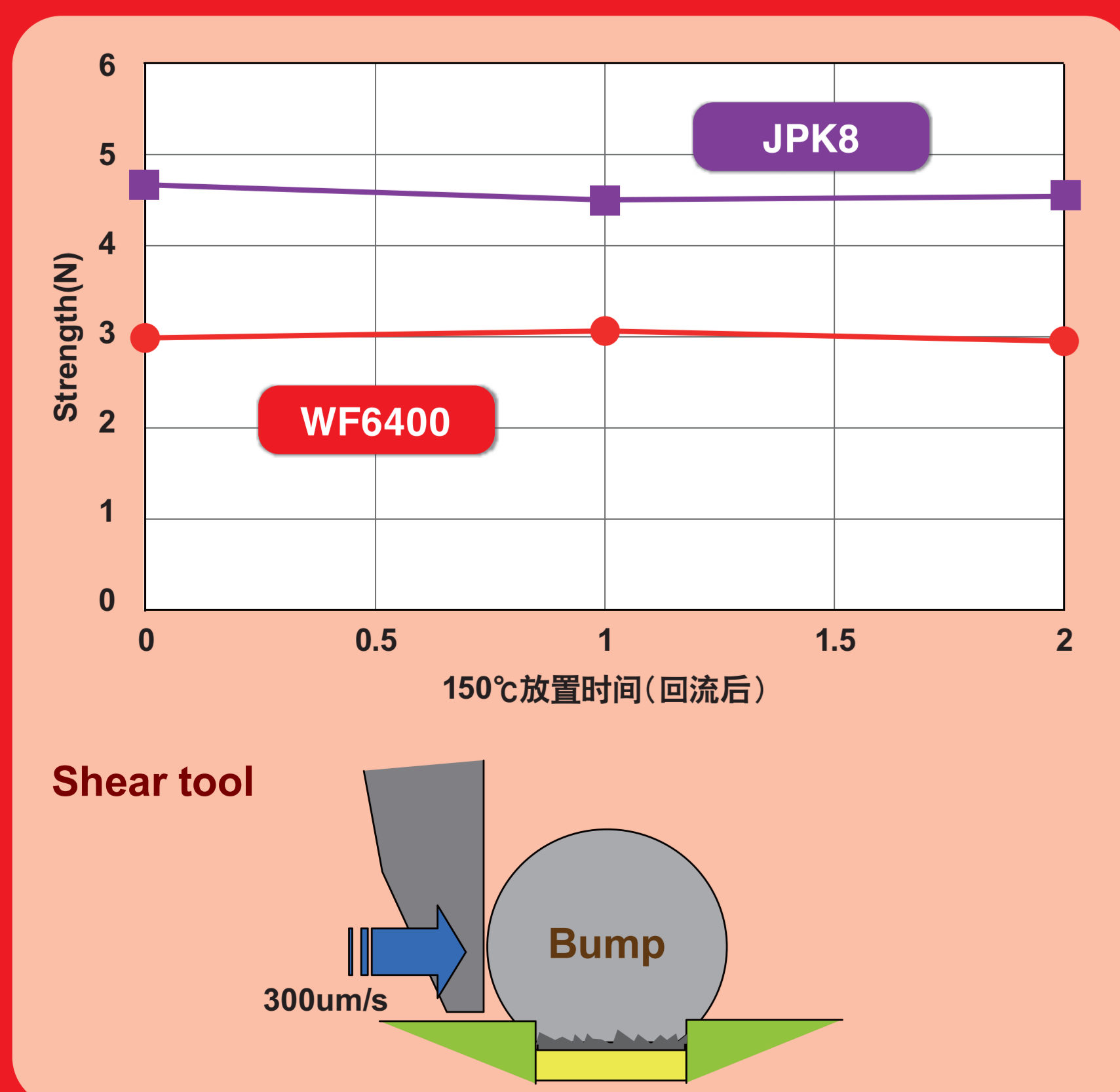
- 固化性能优异，实现免清洗，与填充材料的粘着性提高。
- 微量挥发成分抑制接合部位的污染，不妨碍填充材料的注入。
- 焊剂残渣成为热固化树脂，增加了焊接部位的强度，提高了接合可靠性。



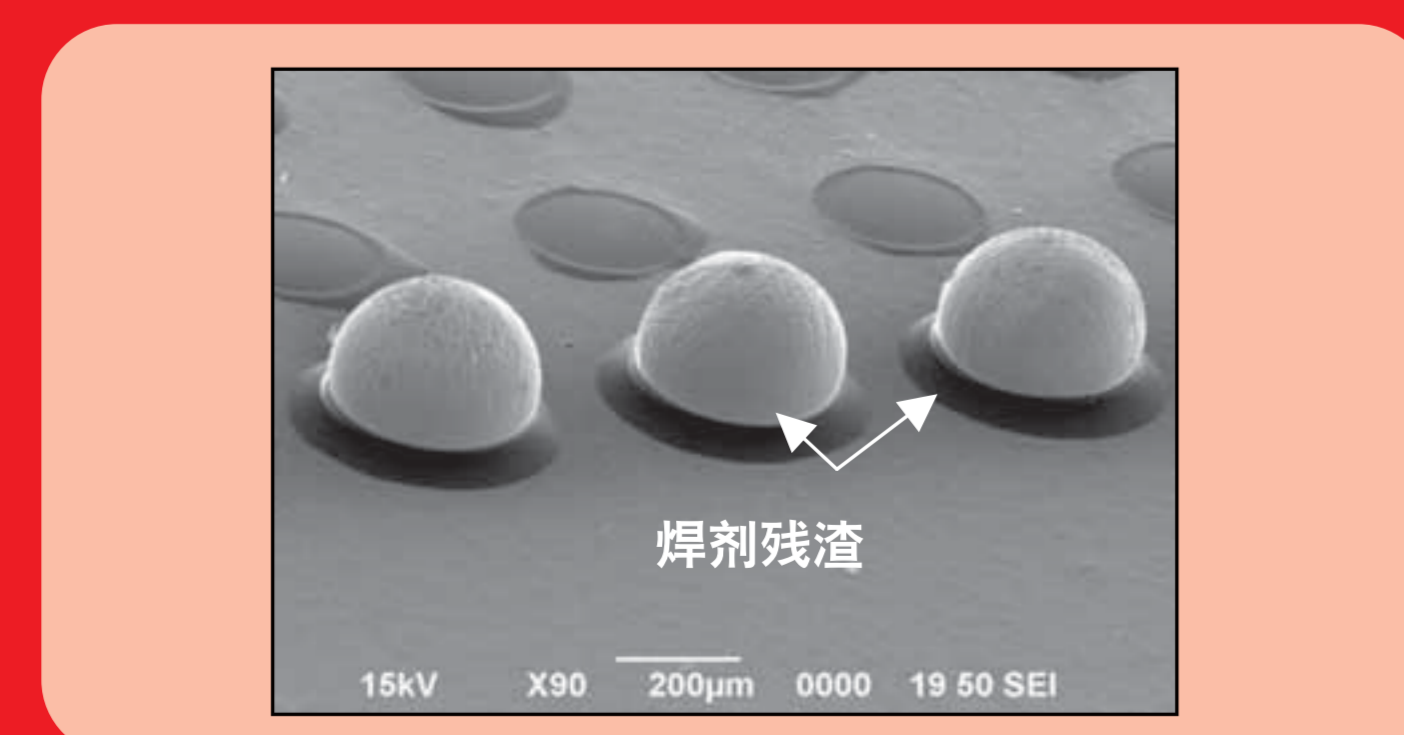
□ 热固化焊剂残渣(低挥发焊剂)，增加接合强度



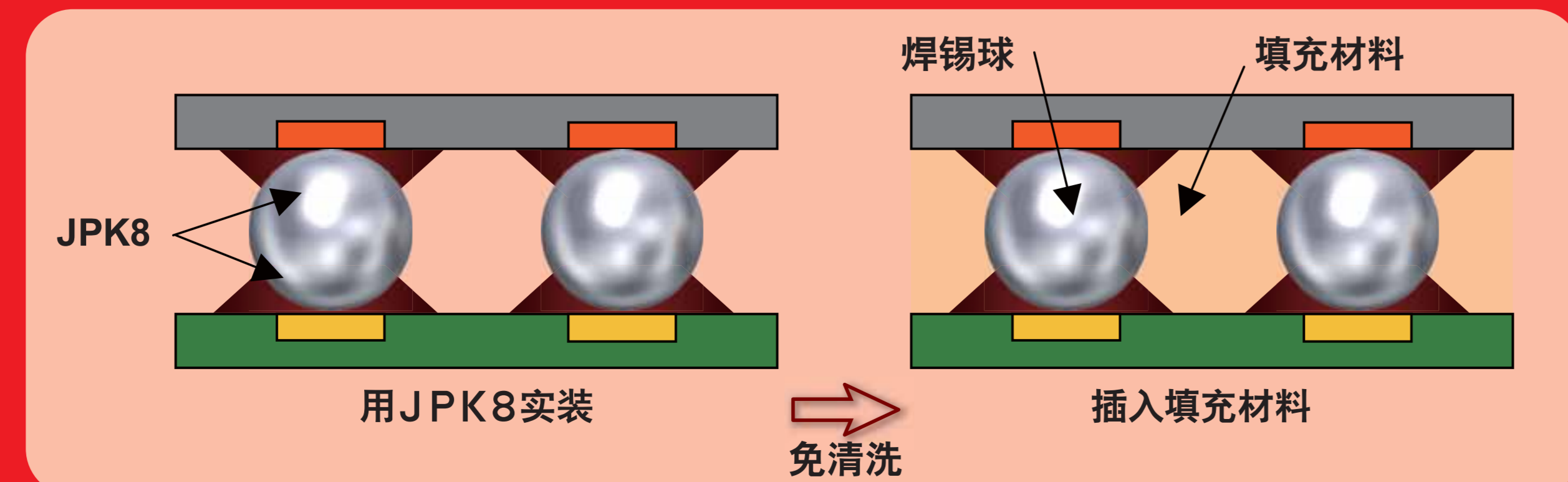
□ JPK8 提高约 50% 的强度



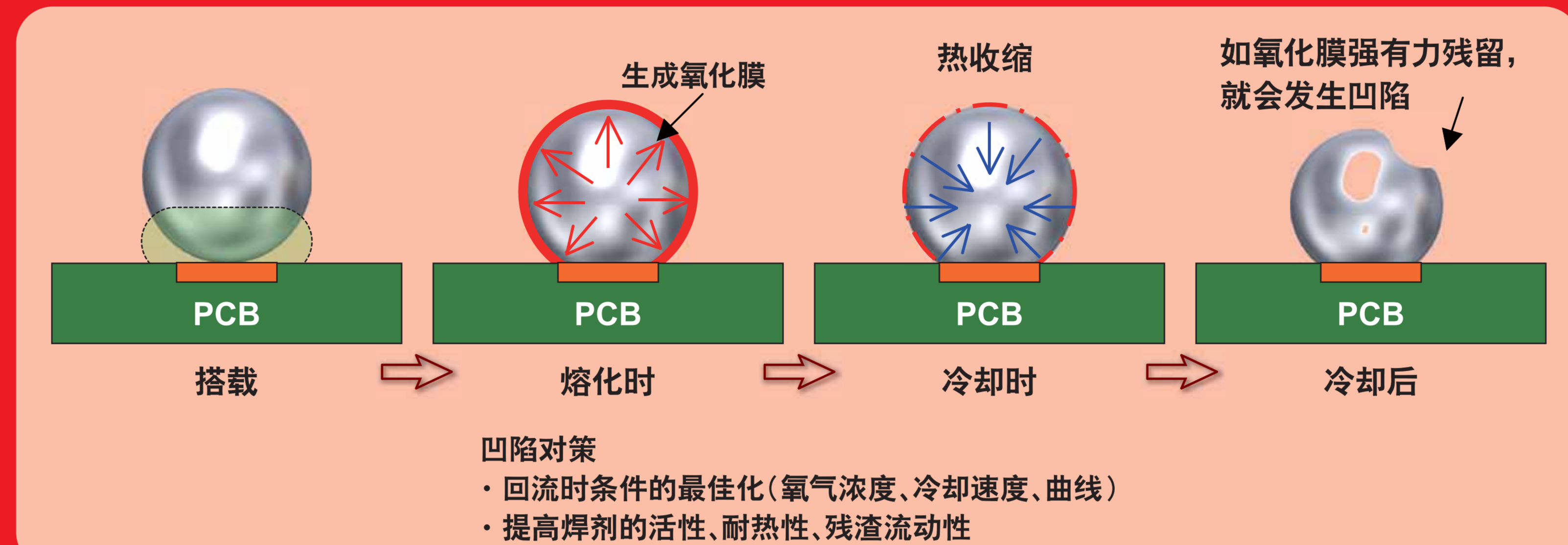
□ 没有覆盖在球表面的焊剂残渣



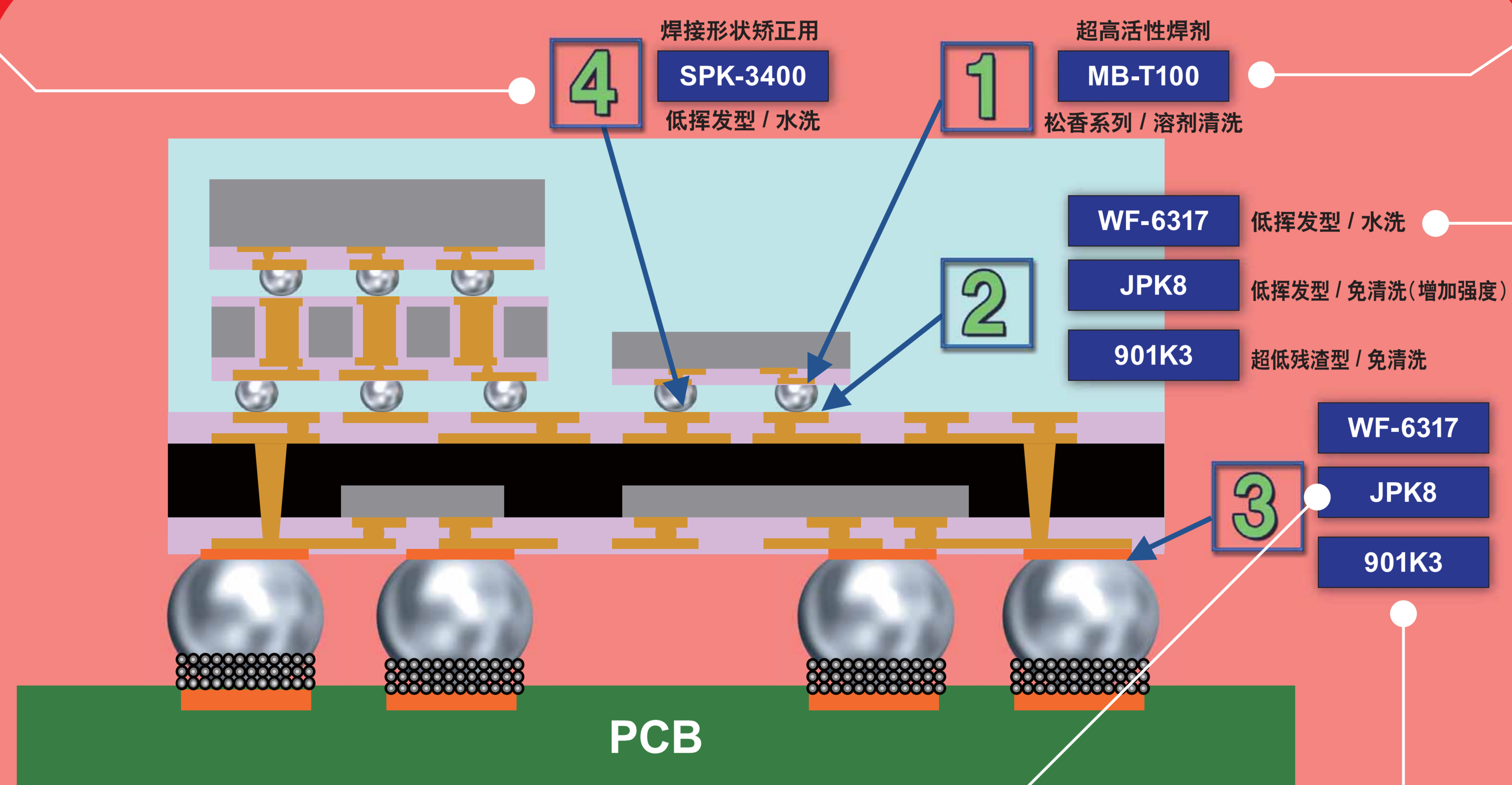
□ 插入填充材料



□ 球凹陷发生机理和对策



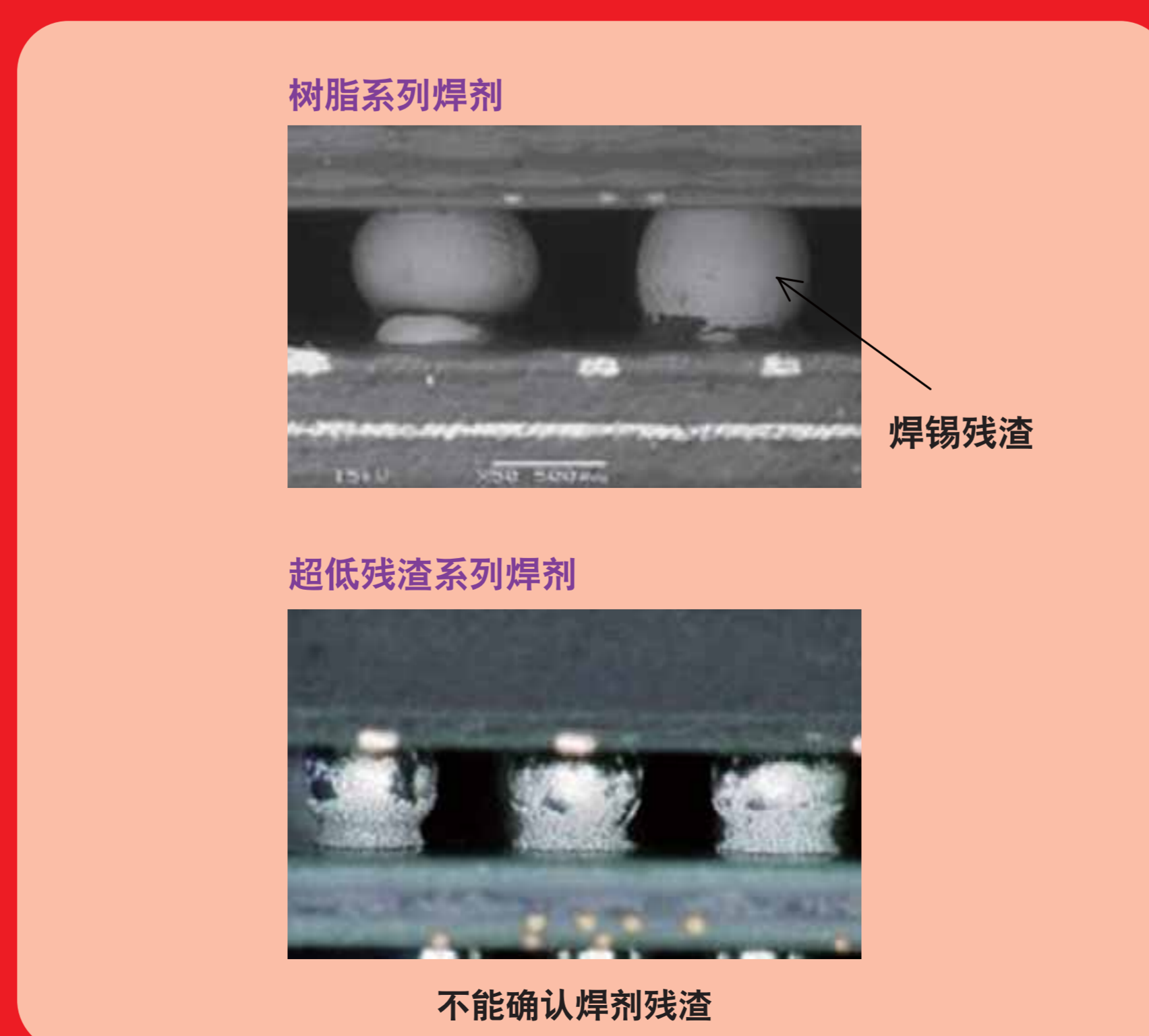
- 凹陷对策
- 回流时条件的最佳化(氧气浓度、冷却速度、曲线)
  - 提高焊剂的活性、耐热性、残渣流动性



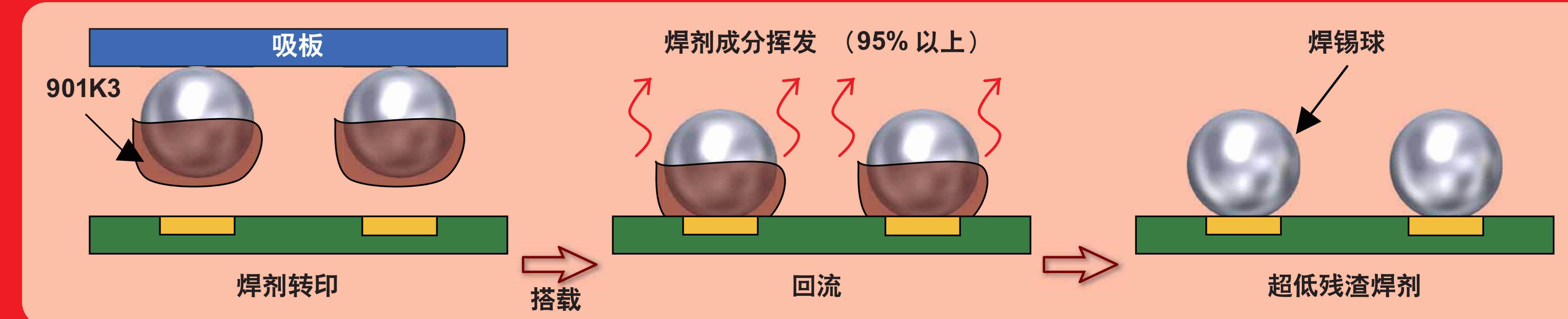
球实用用 向除晶片以外的球连接	松香系列	溶剂清洗 (准水洗)	以往型	GTN-68
	非松香系列	水洗 水溶性焊剂	低挥发型	WF-6317
		免清洗	低挥发型	JPK8
装球用 晶片、球之间的接合	松香系列	溶剂清洗	以往型	MB-T100
	非松香系列	水洗	以往型	WF-MB09
		免清洗	超低残渣型	901K3
形状矫正用 焊锡球状矫正	松香系列	溶剂清洗	以往型	7200A
	非松香系列	水洗	低挥发型	SPK-3400

Smart Connection

□ 与树脂系列焊剂的残渣比较



□ 回流后，95%以上成分挥发，实现超低残渣



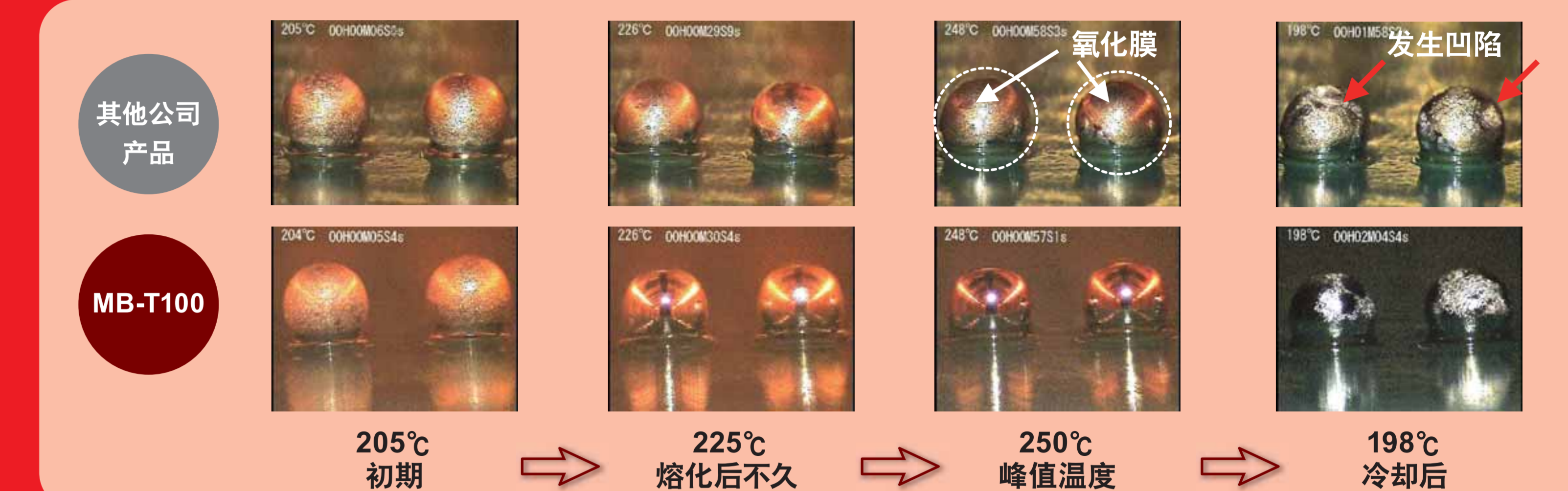
超高活性松香系列微细焊锡球用助焊剂  
MB-T100 系列

## MB-T100

特点

- 无卤素品也系列化 再凝固后仍可重现球形，最适合球凹陷对策
- 活性、耐热性、残渣流动性优异，可抑制球凹陷
- Clean Through750 系列等，可用准水系清洗液进行清洗

□ 改良焊剂，抑制凹陷



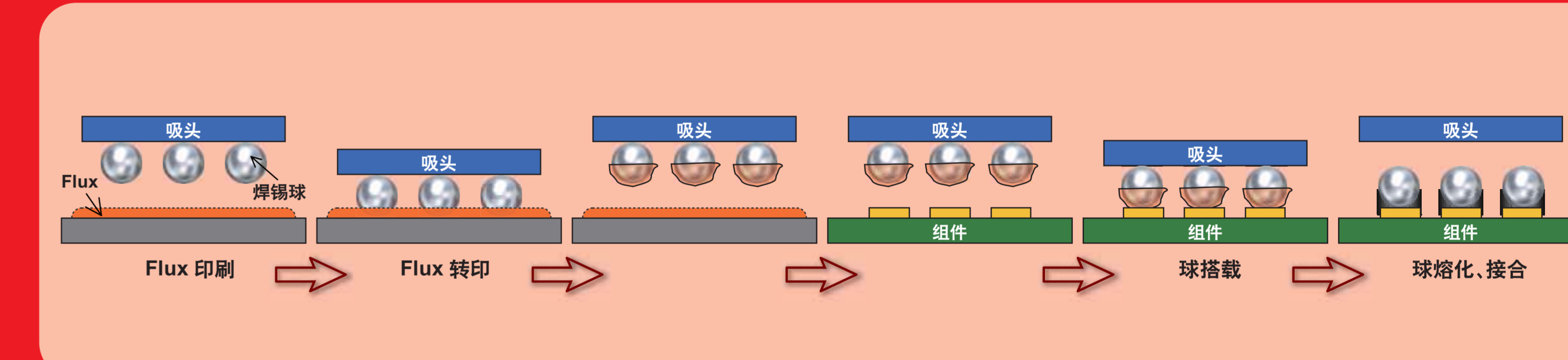
水溶性焊剂  
Sparkle Flux WF-6317

## WF-6317

特点

- 高活性型、高耐热、低挥发焊剂
- 采用低挥发性焊剂，防止回流炉内污染
- 对 Cu-OSP 基板具有良好焊接性能的

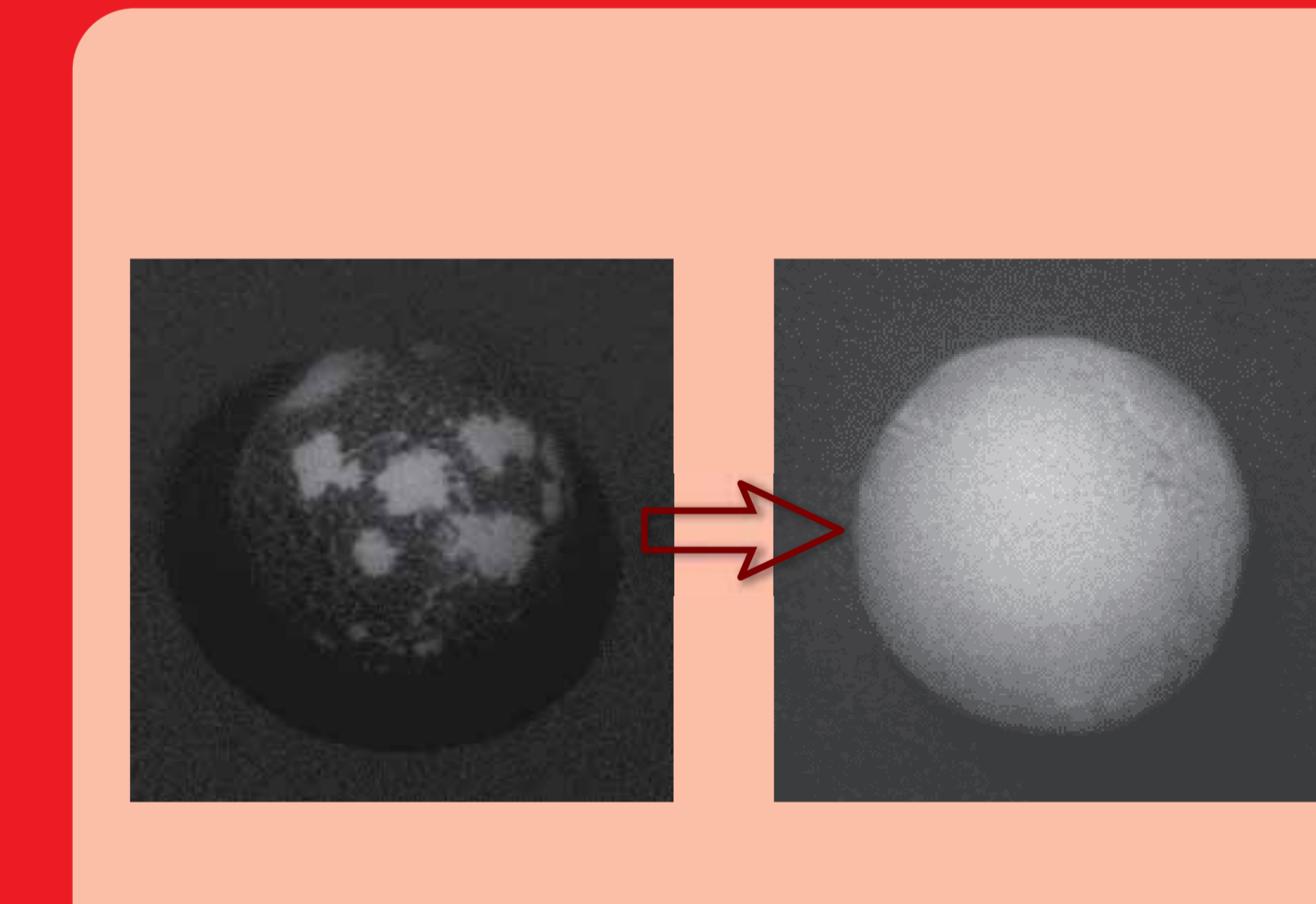
□ 以良好的滑动性和球保持力，安装焊锡球



□ 水洗焊剂残渣



□ 球表面的清洗确认



轻松免清洗、  
超低残渣球实用助焊剂

## 901K3

特点

- 免清洗、超低残渣型转印用焊剂
- 免清洗，可以进行填充料注入工序
- 最适于窄间距、窄缝隙、清洗困难的实装